

## 『無加圧シンタリングに関連する材料・接合技術の最新動向』

SiCやGaN等のワイドバンドギャップ（WBG）半導体を用いたパワーデバイスの性能・信頼性の向上には、高電圧、大電流通電性能、高温動作等を可能にする接合技術が不可欠です。今回はセミシンタリングと無加圧シンタリングに関連する材料と接合技術にフォーカスを絞り、最先端の研究開発動向を講演いただきます。新たな技術開発のヒントやビジネスのきっかけとなれば幸いです。多数のご参加をお待ちしております。

- ・日時 : 2025年2月27日（木） 12時50分～17時00分
- ・場所 : 大阪公立大学 I-Siteなんば C2+C3室  
<https://www.omu.ac.jp/isite/access/>  
**現地開催のみ 定員：100名（先着申込順）**
- ・主催 : 一般社団法人 エレクトロニクス実装学会 関西支部

I-siteなんば  
アクセス

## プログラム

## ・13:00-13:55 基調講演

## 「ワイドバンドギャップパワーデバイスの特性を活かすパワーモジュール/ゲート制御技術」

東北大学 高橋 良和 氏

パワーエレクトロニクス応用製品に対し東北大学の筆者のグループで現在研究開発を進めているワイドバンドギャップパワーデバイスの性能を極限まで引き出すための高放熱化技術、低インダクタンス化技術、高精度ゲート駆動技術などに関して発表する。

## ・14:00-14:30 技術講演1

## 「パワーモジュールへ適用される無加圧セミシンタリング技術の紹介」

住友ベークライト 佐藤 健太 氏

近年パワーモジュールの高パワー密度化に伴い高放熱性能が求められている。当社では無加圧セミシンタリング材料をダイアタッチ材として開発しこれを大面積冷却器接合へ展開している。ここで高放熱性と高信頼性を両立させる技術について紹介する。

## ・14:35-15:05 技術講演2

## 「銅基板へ接合可能な無加圧高強度シンターペーストの開発」

ニホンハンダ 越智 豊 氏

近年のシンターペーストは、加圧タイプと無加圧タイプに大別される。それぞれメリットデメリットがあるが、本稿では、粒子組み合わせ技術により「加圧同等の無加圧高強度シンターペースト」を開発したので発表する。

・15:05-15:20 休憩

## ・15:20-15:50 技術講演3

## 「無加圧焼結Ag接合材およびハイブリッド焼結Ag接合材の最新動向」

田中貴金属工業 近藤 剛史 氏

近年、同じダイアタッチでも加圧焼結とは異なる用途、ニーズで無加圧Ag焼結接合材は開発および普及されてきた。その一つが樹脂入り焼結Ag接合材である。ここでは無加圧の焼結Agおよび樹脂入り焼結Ag接合材の最新動向を紹介する。

## ・15:55-16:25 技術講演4

## 「無加圧短時間実装可能なAg焼結ペースト」

千住金属工業 堀江 竜気 氏

近年、パワーデバイスへのAg焼結材料の適用が進んでいる。我々は、従来使用されてきたはんだ材料からの切り替えという点に着目し、無加圧短時間で焼結可能なAg焼結ペーストを開発した。本講演では、その特性と現状の課題について紹介する。

## ・16:30-17:00 技術講演5

## 「京セラの無加圧シンタリングペーストのラインナップとそのアプリケーション事例の紹介」

京セラ 似内 勇哉 氏

パワー半導体や環境規制、小型化の進展により、シンタリング材料が高信頼性と効率性の面で注目されている。

ここでは、当社の無加圧シンタリングペーストのラインナップと、それぞれの特徴について紹介する

・17:00-17:05 閉会挨拶・終了

◆定員 100名 (先着申込順)

◆参加費 (税込、名刺交換会費込)

会員/賛助会員/協賛学会会員 : 10,000円

シニア会員 : 5,000円 非会員 : 14,000円

学生会員 : 1,000円 一般学生 : 2,000円

※賛助会員クーポン利用不可

### 【名刺交換会】

開催時間 : 17時30分~19:00予定

場所 : I-siteなんば A1・A2

申込締切 : 2025年2月20日 (木)

### 【参加申込】

※名刺交換会参加希望者は、**【名刺交換会参加】**を選択ください。

会員

シニア・学生会員

賛助会員

協賛会員

非会員

一般学生



### 【決済方法・支払期限】

クレジットカード、コンビニ決済

学会会員のみ : 銀行振込(バーチャル口座 : 手数料をご負担ください)

請求書・領収書発行 : 申込登録完了メールのマイページURL⇒ログイン

⇒決済タブ⇒PDFダウンロード (宛名選択可能です)

支払期限 : 2025年2月25日 (月)

### 【協賛会員】(予定)

日本電子回路工業会 (JPCA)、表面技術協会関西支部、応用物理学会関西支部、高分子学会関西支部、電気学会関西支部、日本接着学会関西支部、スマートプロセス学会エレクトロニクス生産科学部会、近畿化学協会エレクトロニクス部会、日本繊維機械学会、化学工学会エレクトロニクス部会、大阪府立大学ものづくりイノベーション研究所、電子情報通信学会、電子部品・材料研究専門委員会、日本セラミックス協会関西支部、電気化学会関西支部



問い合わせ先 : 一般社団法人 エレクトロニクス実装学会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2

お問合せMail : E-mail: info@jiep.or.jp

ホームページ: <https://jiep.or.jp>

